

The background features a stylized globe with a grid of latitude and longitude lines. Overlaid on the globe are various digital and circuit-like elements, including binary code (0s and 1s), concentric circles, and a large white plus sign in the upper left. The overall color scheme is a gradient of blues and greens.

环球晶圆股份有限公司

**GlobalWafers,
Global Family,
Global Solutions!**



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

www.sas-globalwafers.com

愿景



探索科技，环球同行
致力成为客户的核心技术伙伴

使命



环球齐心，未来永续
整合集团力量，专注全方位服务

公司概况

- 创立时间：2011年
自中美矽晶制品股份有限公司独立分割
- 总部位置：台湾，新竹科学园区
- 产品：提供各式尺寸的晶圆产品
- 员工：7,000人
- 营运据点：遍布亚洲、欧洲及美国

独特优势

- 全球第三大，同时也是全球最大的非日系硅晶圆供货商
- 营运据点遍布亚洲、欧洲及美国，提供环球晶圆绝佳的生产弹性及研发技术
- 独特的营运模式及市场优势使环球晶圆自半导体产业链中脱颖而出

01 全球布局，稳定供应

- 18 个生产及营运据点
遍布全球 9 个国家
- 灵活调配全球产能、实现弹性出货

02 完整的产品光谱

- 3吋至12吋各式晶圆产品
- 提供客制化产品规格
满足客户多样化需求

03 环境、社会与公司治理(ESG)

负责任的成长是环球晶圆的营运准则，我们致力成为全球标竿，与环境共荣共存

- (E)环境: 追求永续发展
- (S)社会: 致力于互助分享与志愿服务
- (G)公司治理: 实践信息透明、履行诚信经营

诚信



创新



人本



卓群



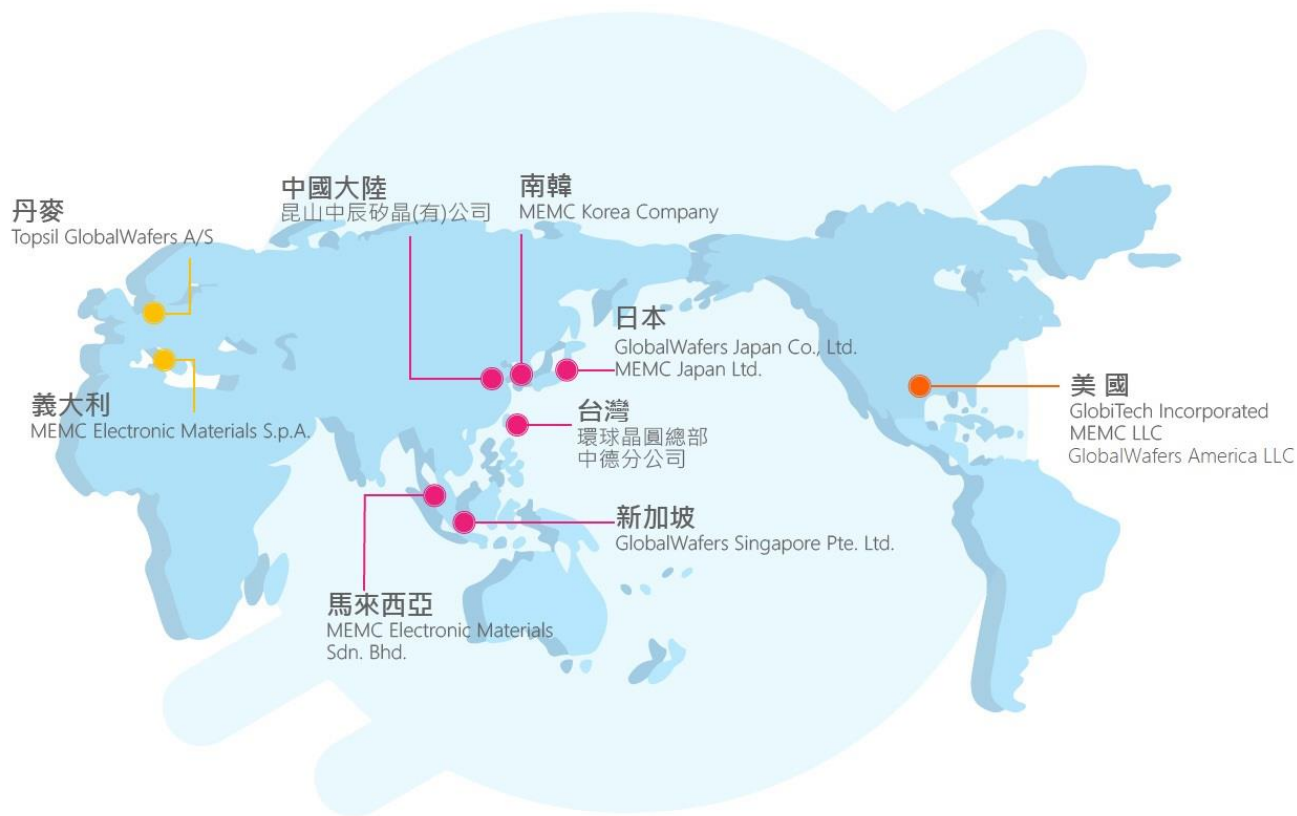
热忱



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

发展沿革

- 1981  中美矽晶製品股份有限公司
Sino-American Silicon Products Inc.
中美矽晶製品股份有限公司成立
- 2008  GLOBITECH
DESIGNING EPI SOLUTIONS
收购 GlobiTech Incorporated
- 2011  GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司
中美矽晶將三大事業體獨立分割
太陽能、半導體、藍寶石
環球晶圓股份有限公司成立
- 2012 | **COVALENT** |
收购 Covalent Silicon Corporation
(收购日本 Covalent Materials Corp. 子公司半导体硅晶圆相关业务，并更名为 GlobalWafers Japan Co., Ltd.)
- 2015
環球晶圓股票挂牌上柜
- 2016  TOPSIL  SunEdison
SEMICONDUCTOR
收购 Topsil
收购 SunEdison Semiconductor



全球布局

- 广泛且遍布世界的营运据点，能实时服务全球客户
- 在地供应可有效降低长途运输的环境成本，亦减轻地缘政治及总体经济的变动影响

产品类别及其应用

01

磊芯片

LE 6"
8"
12"

车用电子
功率组件
MPU / MCU
CMOS 影像传感器

02

抛光片

LE 6"
8"
12"

内存
功率组件
模拟IC / 逻辑IC
通讯设备

03

FZ芯片

LE 6"
8"

医疗器材
风力发电
高速铁路
车用电子

04

SiC芯片

LE 6"
8"

车用电子
高速铁路
风力发电
高压功率组件

05

退火片

8"
12"

内存
液晶驱动器
模拟IC / 逻辑IC

06

扩散片

LE 6"

车用电子
电力设备
航天设备

07

非抛光芯片

LE 6"

分离式组件

08

SOI芯片

LE 6"
8"
12"

MEMS 传感器
CMOS
射频组件
高压功率组件
光子组件

09

GaN/Si, GaN/SiC

LE 6"
8"

太阳能逆变器
功率组件
射频组件

产品光谱广泛

• 环球晶圆产品光谱横跨3至12吋，满足客户的全方位需求

• 环球晶圆深化客户研发连结，以掌握市场趋势，生产最新产品

深化研发连结 掌握市场脉动

01

FZ芯片

- **8" 中子照射掺杂(NTD)**，应用于高压功率组件
- **8" 气相掺杂(PFZ)**，应用于一般功率组件

02

ECAS

- **无COP缺陷**的抛光片
同时具备高强度与高吸杂能力
- 可广泛运用于**内存、影像传感器、3D IC组件**

03

12" SOI

- **RF SOI** 搭载高阻基板
- **CTL SOI** 搭载高阻基板与Charge Trap Layer
- 亦支援**光子组件、CMOS影像传感器**之相关应用

04

宽能隙材料

- **6" n型碳化硅(SiC)抛光片**，应用于高压功率组件
- **4" 半绝缘碳化硅(Si SiC)抛光片**，应用于高频组件
- **6"/8" 硅晶圆上氮化镓磊晶 (GaN Epi on Si wafer)**
于高压高功率及射频组件之应用



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

永续发展

- 负责任的成长是环球晶圆的营运准则
- 环球晶圆致力在环境保护、健康安全与公司治理三大面向成为全球标竿

社会面

01 互助分享

改变社会

环球晶圆鼓励员工透过回馈社会、关爱弱势群体来传递爱心，以实现更美好的世界。

02 志愿服务

善良为首要之务

环球晶圆透过不定期的志工服务，形塑互助与分享的共同目标，以成就更美好的明天。

公司治理面

01 诚信经营



法令遵循



申诉系统



道德与行为准则



风险评估

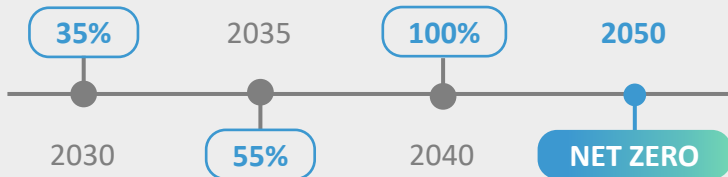
02 公司治理

获选台湾公司治理评鉴前百分之五之上柜公司

环境面

01 承诺于2040年100%使用再生能源

阶段式目标与气候蓝图：



采取措施：



采用再生能源



提升能源使用效率



碳清除



购买碳补偿商品



价值链减碳

02 水资源回收与再利用



台湾区超过50%的水资源可被回收再利用

03 4R 策略

环球晶圆遵循4R策略，实践兼顾生态的循环经济，以完善产线设计、专注源头减量为目标

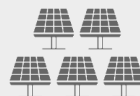
Reduce

Reuse

Recycle

Redesign

04 太阳能电厂



环球晶圆兴建太阳能电厂，确保电力供应、扩大绿色能源使用

05 废弃物管理

全球厂区超过80%的废弃物皆可回收及再利用



GlobalWafers Co., Ltd.
环球晶圆股份有限公司



让我们一起徜徉 在环球晶圆的世界！

想探索更多环球晶圆吗？
欢迎浏览环球晶圆官网以了解最新资讯
(www.sas-globalwafers.com)



详细信息
请至官网查询

30075
台湾新竹市科学园区工业东二路8号

电话: +886 (3) 5772255
传真: +886 (3) 5781706



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司